

Boron-free nickel sulfamate plating

ほう素フリースルファミン酸ニッケルめっき薬品

スルファミン酸ニッケルは優れためっき特性を生かした高精度・高品質の表面処理薬品として、長年にわたり品質のご信頼を賜っております。

従来スルファミン酸ニッケル浴には必須の緩衝剤としてほう酸が添加されておりましたが、ほう酸を含むめっき排水の処理が問題となっております。この問題に対する抜本的な解決策として、ほう酸を全く含有しない環境対応型の当製品を開発致しました。

● 特長

- ほう酸を含有せず、排水処理が容易です。低温での結晶析出もありません。
- 作業条件により、めっき皮膜物性を管理できます。
- 従来設備がそのまま使用できます。
- めっき皮膜の電着応力が低く、延性や抗張性に優れています。
- 従来のスルファミン酸ニッケル浴と同じくワット浴よりも高速めっきが可能です。
- めっき組成管理が容易です。

● 用途

- 精密金型、印刷スクリーンメッシュ、スタンパー等の電鍍品。
- プリンターヘッド、圧着センサー等の MEMS 向け精密部品。
- コネクタ接点部等の電子部品。

● 建浴

ほう素フリースルファミン酸ニッケルめっき建浴剤を原液使用します。
必要に応じてスルファミン酸ニッケル専用光沢剤を添加してください。

● 作業条件

	範囲
浴温	40～60℃
陰極電流密度	1～10A/ dm ²
pH	4.0～5.0
ろ過	連続ろ過
加熱方式	熱交換式
陽極	硫黄入りニッケル

● 液管理・使用上の注意点

連続電解においては、補給液を 10AH 毎に 1mℓ 添加してください。
pH 調整は、下降にはスルファミン酸、上昇には炭酸ニッケルをご使用ください。